**杭州士兰微电子股份有限公司**

**半导体制造事业总部2020届校园招聘简章**

**一、企业简介**

**士兰半导体制造事业总部**隶属于杭州士兰微电子股份有限公司（**股票代码600460**），业务涵盖**“功率半导体芯片制造”、“LED照明和化合物半导体制造”、“封装测试”**三大事业门类，下辖“杭州士兰集成电路有限公司”、“杭州士兰集昕微电子有限公司”、“杭州士兰明芯科技有限公司”、“杭州士兰全佳科技有限公司”、 “成都士兰半导体制造有限公司”、“成都集佳科技有限公司”、“厦门士兰集科微电子有限公司”及“厦门士兰明镓化合物半导体有限公司”8家公司。现有中外员工近5000人，年产值规模30亿左右。

经过十多年的发展，目前在小于和等于6吋的芯片制造产能中，全球排名第五名；士兰集昕微电子有限公司8吋生产线于2017年6月底正式投产，现已具备特色工艺产品主流制造水平；化合物半导体产线已于2019年上半年完成厂房净化和动力设备安装，预计2019年Q4进行试生产；12吋线预计于2020年投产，这些将会为士兰进一步发展夯实基础。主要产品包括：电源及功率驱动产品、MEMS传感器产品、MCU产品、分立器件产品、PIM功率模块产品等，并广泛应用于各类消费类电子产品中，远销至世界各地。

风雨同舟，共见彩虹，下辖企业先后斩获“国家科技进步二等奖”、“全国五一劳动奖”、“中国半导体创新产品和技术奖”、“电子行业半导体民族品牌”、“国家鼓励的集成电路企业”等荣誉，并获国家产业基金及地方半导体基金的大力支持，为士兰发展如虎添翼。腾飞中的士兰一直秉承着“人才、技术”为首的人才观；“诚信、忍耐、探索、热情”的企业精神；“追求卓越、不断创新”的研发理念，不断开拓新的工艺领域；以“振兴民族产业”为己任，努力成为具有自主品牌和国际一流竞争力的综合型的半导体产品供应商！

共襄士兰芯梦，我们期待您的加入！

**二、招聘需求**

**本次校园面向：**杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、 厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司，共计4家公司。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位名称** | **需求专业** | **需求人数** | **学历层次** |
| 产品研发工程师 | 微电子、电子科学与技术、集成电路等类似专业 | 110 | 研究生/本科 |
| 工艺工程师 | 材料、物理、化学等类似专业 | 110 | 研究生/本科 |
| 设备工程师 | 自动化、电气、机械、测控类等类似专业 | 120 | 本科 |
| 水处理/暖通工程师 | 环境工程/给排水/暖通等相关专业 | 6 | 本科 |
| PMC/制造主管 | 工业工程等类似专业 | 6 | 本科 |
| 会计 | 财务管理等类似专业 | 4 | 本科 |
| 系统/运维/网络/CIM软件工程师 | 计算机/数学/运筹学/软件工程等类似专业 | 10 | 本科 |
| 科技项目管理管培生 | 经济管理类似专业 | 2 | 研究生 |
| 人力资源管培生 | 人力资源管理、心理学、工商管理等类似专业 | 5 | 研究生/本科 |

**三、福利发展**

1、提供具有竞争力的宽带薪酬和多轨制职业发展平台；

2、提供完善的培训体系：人才IDP培养培训体系、专业技能提升培训体系、学历提升平台及专项资金支持（与浙江大学合作开设工程硕士班）；

3、提供完善的社会保险、住房公积金及关爱员工体系（人生关键时刻的慰问礼金）；

4、提供完善的福利体系（佳节福利2000-3000元/年、员工专项活动经费，资助旅游、探亲假等）；

5、重才爱才先进单位，享有各类人才引进津贴；

6、自建自营餐厅，每月发放工作餐补贴，健康实惠；

7、工作环境：常年恒温恒湿，冬暖夏凉，且每年6-9月份提供“防高温补贴”；

8、免费提供住宿：3人间，免费宽带，宿舍配有空调、独立卫生间、热水器等。

**四、招聘流程：**

①网申**（预计9月13日开启）**:

简历投递→简历筛选→通知就近宣讲会→笔试→面试→OFFER,请参加就近学校宣讲会。

②现场投递:参加宣讲会→简历投递→笔试→ 面试→OFFER,请参加宣讲会。

士兰2020届校园招聘会详细介绍**（预计9月13日开启）**，届时请关注士兰公众微信号或者登录士兰公司网站(http://www.silanic.com.cn)了解更多校园招聘行程安排。

 

**五、联系方式:**

联系人：人力资源部 曹先生（杭州HR）/徐先生(厦门HR)

联系电话：0571-86714088-66976（杭州）/75427（厦门）

地址：杭州经济技术开发区东区10号大街东300-308号